

公益社団法人精密工学会 プラナリゼーションCMPとその応用技術専門委員会
第154回研究会開催のご案内

このたび、プラナリゼーション CMP 専門委員会では、下記のとおり【CMPの応用広がる電子部品と新しい加工方法】と題して第154回研究会を開催いたします。会員各位の多数の皆様のご参加をお待ちしています。また、非会員の方のご参加も有料にて受け付けております。なお、研究会終了後、情報交換会を行いますので、是非ご参加下さい。



日 時：2016年12月22日（木）13:00～19:00

（研究会・・・13:00～17:20 9F「スズラン」、情報交換会・・・17:30～19:00 8F「スイセン」）

開催場所：プラザエフ（JR四ツ谷駅麹町口から徒歩1分）

東京都千代田区六番町15（TEL：03-3265-8111）

内 容：

13:00～13:05 開会挨拶（檜山委員長）

13:05～13:10 前回議事録確認

13:10～17:15 話題提供

「テーマ：CMPの応用広がる電子部品と新しい加工方法」

13:10～13:15 趣旨説明（礮部幹事・宮嶋幹事・畝田幹事）

1) 13:15～14:00 電子部品業界／市場動向と進化の方向性

株式会社産業タイムズ社 松下 晋司氏

<概要>

2016年世界の電子部品市場は約24兆円。このうち、日系企業は38%のシェアを制す。国内電子デバイス産業においては、半導体を抜き取り、名実ともにリーディング産業の地位を勝ち取った。中・韓・台アジア勢の猛迫を受ける中、国内電子部品業界の今後の進化の方向性を探る。

2) 14:00～14:45 高周波SAW/BAWデバイスの現状と平坦化技術の役割

千葉大学 大学院工学研究科教授 橋本 研也氏

<概要>

現在の携帯電話・スマートフォンには弾性表面波(SAW)並びにバルク弾性波(BAW)を用いた高周波フィルタ・アンテナ共用器が多数搭載されている。これらの素子では短波長の弾性振動を利用しているため、表面の僅かな荒れや材料の不均一性が致命的な性能劣化や製造歩留まり低下を引き起こす。本講演では、高周波SAW/BAWデバイスの動作原理並びに現状を紹介すると共に、それらの素子の製造過程における平坦化技術の役割について議論する。

3) 14:45～14:55 学会報告（ICPT2016）黒河副委員長

.....

14:55～15:10 コーヒーブレイク

.....

4) 15:10～15:50 砥粒を用いない新しい研磨方法

熊本大学工学部 准教授 久保田 章亀氏

<概要>

一般的な研磨においては、砥粒と薬品を配合した研磨剤(スラリー)が用いられ、これらによって、高精度な仕上げ面を得ている。しかしながら、研磨資材コストや研磨後の研磨資材の処理コストが高くつく傾向にある。ここでは、スラリーを用いることなく、高硬度なセラミックスやガラスをはじめ、次世代半導体基板として有望視されているSiCやダイヤモンドを低コストで高精度に研磨できる新しい研磨法をご紹介したい。

5) 15:50～16:30 レーザーを利用した新しいSiCスライシング加工技術 (KABRA)

株式会社 ディスコ 平田 和也氏

<概要>

SiC パワーデバイスは、Si に比べ、省エネ化が期待できる。しかし、硬度の高さ(モース硬度:9)からウェーハ化のためのワイヤー切断工程におけるスループットの低さと材料損失が課題となり、コスト高の原因となっていた。そこで、我々はレーザーを利用した新しいスライシング方法(KABRA)を提案する。KABRA を利用することにより、遊離砥粒ワイヤソーに比べ、6 インチウェーハの取枚数を約 40%増、スループットを約 4.5 倍の向上を実現する。

<年末恒例特別企画>

6) 16:30～17:10 お楽しみ講演；知れば知るほど奥が深い古事記と神社のミステリー

株式会社 ISTL 磯部 晶氏

<概要>

あなたの近所の神社のご祭神はご存知ですか？身近な神社が古代のミステリーにつながっているかもしれません。古事記に語られるストーリーと古事記成立の時代、そして現代まで続く神社との関係を解き明かしていきます。

17:10～ その他（事務連絡）

17:20～ 閉会の挨拶

17:30～19:00 （情報交換会・懇親会）

参加費：

1. 企業会員：無料（年会費 100,000 円）
2. 官学会員：無料（年会費無料・要登録）
3. 非会員：30,000 円（今回の研究会のみの参加費）

※ご入会検討でお試し参加される場合、初回のみ一人様 15,000 円でご参加頂けます。

※参加費にはプロシーディング代、懇親会費が含まれます。

※人数確認のため会員の方も必ず事前に申込書の提出をお願い致します。

※準備の都合上、懇親会ご参加有無について必ず記入をお願い致します。

お申込み・お問合せ先：「プラナリゼーションCMP 専門委員会」事務局（三上）行き
TEL：03-5117-2225，FAX：03-5117-2223，E-mail：mikami@global-net.co.jp

2016 年 12 月 22 日（木）開催 第 154 回研究会 参加申込書

会員 / 一般（いずれかにチェックしてください）

氏名				
勤務先・所属				
参加内容 (参加されるものに○を付けて下さい)	研究会		情報交換会（懇親会）	
連絡先	住所			
	TEL		FAX	
	E-mail			